

2023年度 第1四半期 決算説明資料

2023.7.20

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

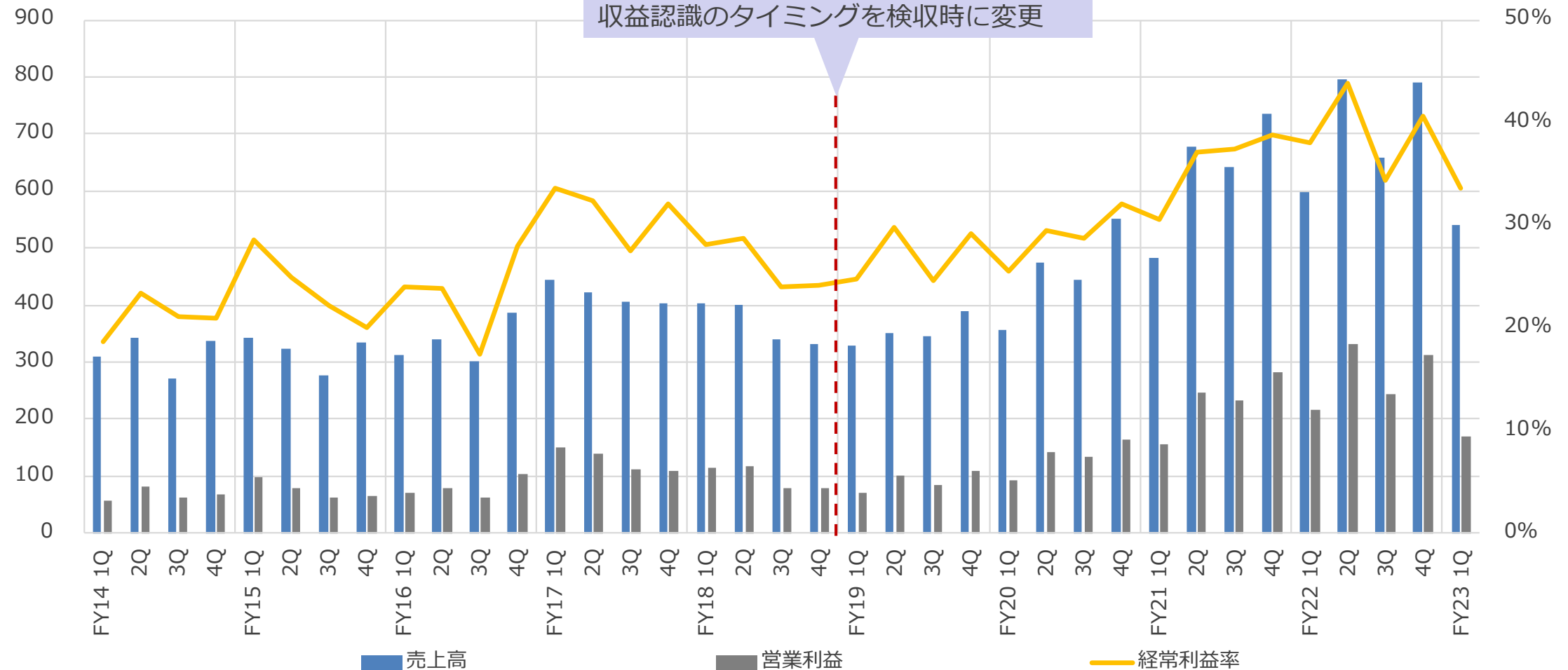
実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

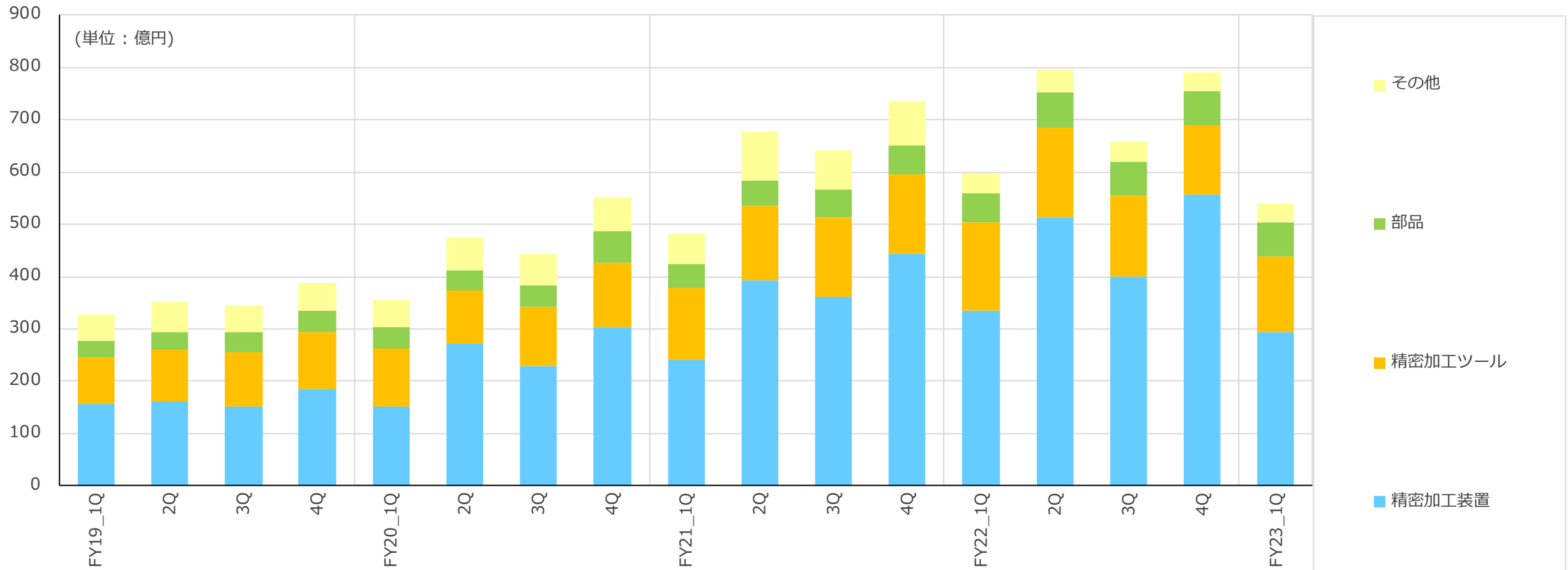
(単位：百万円)	FY2023	FY2022	QoQ		FY2022	YoY	
	1Q	4Q	差額	(%)	1Q	差額	(%)
売上高	53,961	79,015	-25,054	-31.7%	59,749	-5,788	-9.7%
売上総利益	35,182	51,224	-16,042	-31.3%	38,135	-2,953	-7.7%
GP率	65.2%	64.8%	0.4p	-	63.8%	1.4p	-
販売管理費	18,209	19,939	-1,729	-8.7%	16,542	1,667	10.1%
営業利益	16,972	31,284	-14,312	-45.7%	21,592	-4,620	-21.4%
経常利益	18,162	32,150	-13,988	-43.5%	22,763	-4,600	-20.2%
経常利益率	33.7%	40.7%	-7.0p	-	38.1%	-4.4p	-
税前利益	18,139	32,726	-14,587	-44.6%	22,737	-4,598	-20.2%
純利益	12,682	25,671	-12,990	-50.6%	16,039	-3,357	-20.9%

売上高： QoQ 検収のタイミングにより減少
 GP率： QoQ 製品構成や為替などの影響により上昇
 販売管理費： QoQ 業績連動により減少、YoY 主に人件費等増加

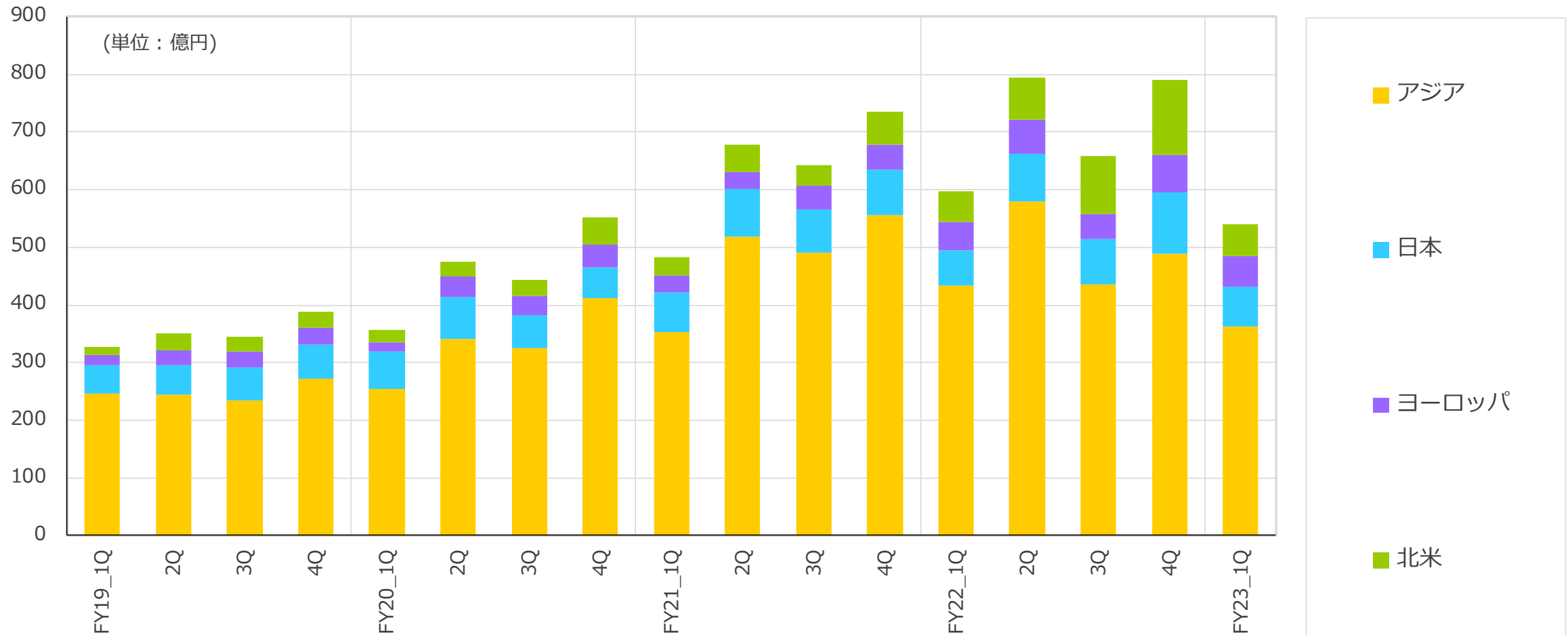
(単位：億円)



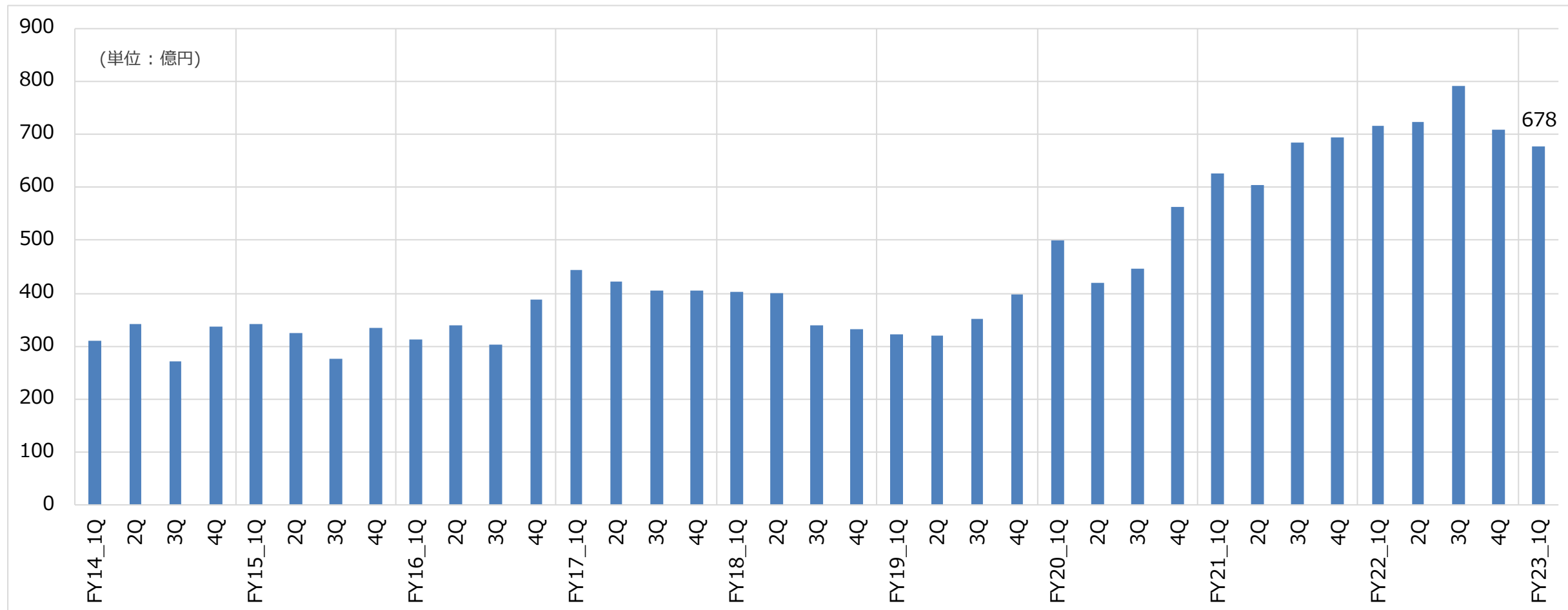
売上高は検収要因で低調、高いG P 率を背景に営業利益率は30%超で推移
(FY23_1Q 営業利益率31.5% 経常利益率33.7% 純利益率23.5%)



※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

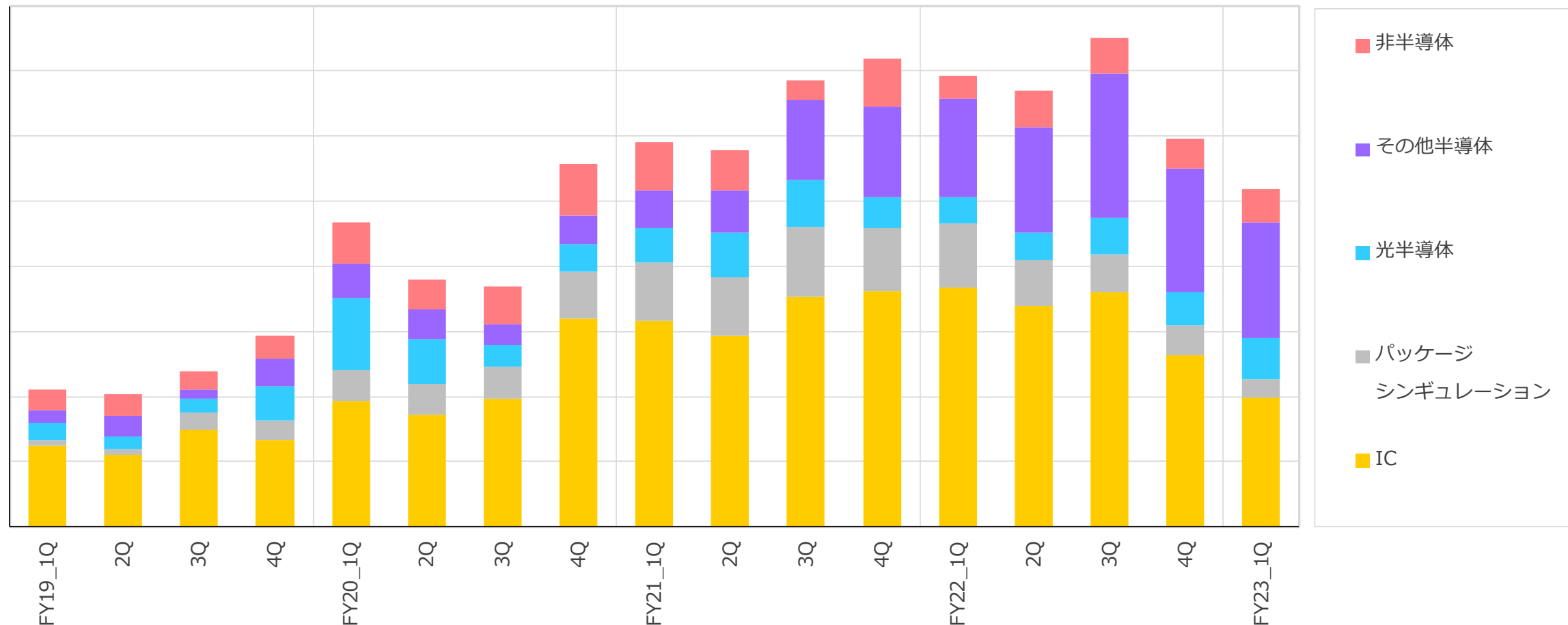


FY23_1Q 海外売上高比率 87.1%



FY23_1Q 出荷額 約678億円

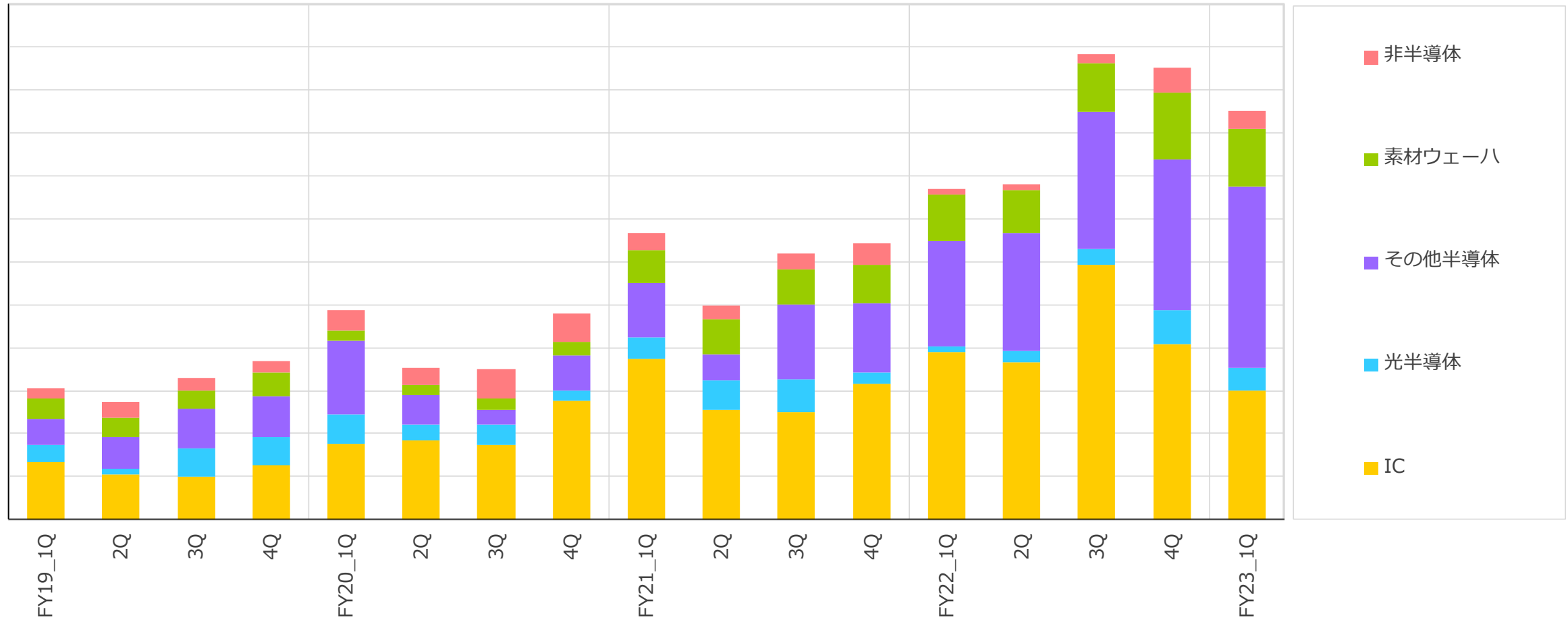
出荷額ベース



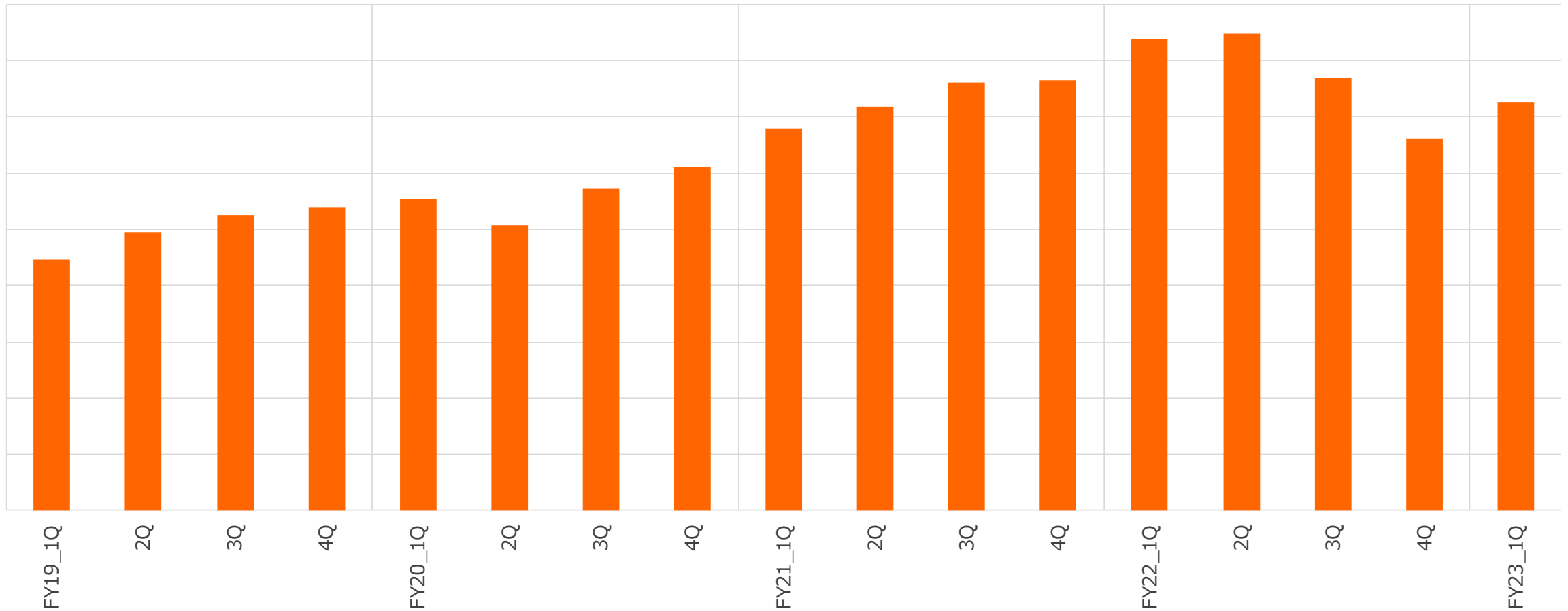
QoQ
YoY

OSAT向けを中心にICが減少
パワー半導体（その他半導体）は増加したが、 ICの減少が全体を押し下げた

出荷額ベース



QoQ パワー半導体（その他半導体）は好調維持もIC向けが減少
 YoY 世界的なEVシフトなどを背景としたパワー半導体の増加が全体を押し上げた



精密加工ツール（消耗品）の出荷はQoQ増加
今後、顧客の設備稼働率や最終製品の需要動向を注視

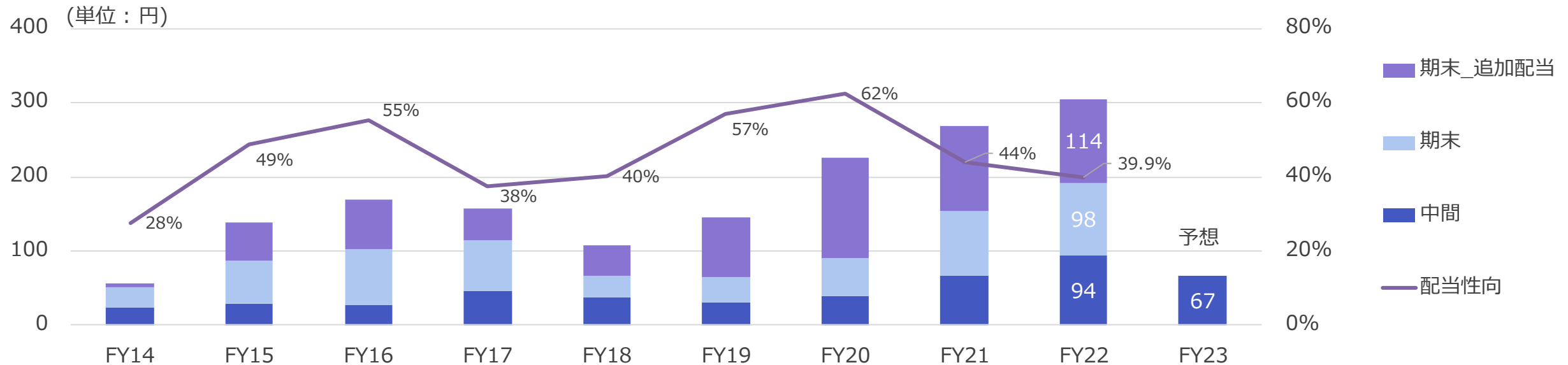
(単位：百万円)	FY2023 1Q	FY2022 4Q	差額
現金及び預金	153,201	163,053	-9,852
受取手形・売掛金	35,421	41,356	-5,935
棚卸資産	98,536	91,384	7,152
流動資産	290,398	305,118	-14,720
有形固定資産	150,038	147,541	2,497
固定資産	164,113	163,678	435
総資産	454,512	468,797	-14,285
流動負債	114,490	119,974	-5,484
固定負債	815	781	34
負債合計	115,306	120,755	-5,449
純資産	339,206	348,041	-8,835
負債純資産合計	454,512	468,797	-14,285
自己資本比率	74.4%	74.0%	0.4p

総資産：配当金など各種支払いにより現預金が減少
 負債：主に未払法人税や賞与引当などが減少
 純資産：主に配当金支払いにより利益剰余金が減少

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 期末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施
(FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載)

(単位：億円)

今回予想

	FY22 1Q	2Q	3Q	4Q	FY23 1Q	2Q
売上高	597	795	658	790	540	653
営業利益	216	333	243	313	170	224
経常利益	228	348	226	322	182	225
純利益	160	246	165	257	127	160
営業利益率	36.1%	41.8%	36.8%	39.6%	31.5%	34.3%
経常利益率	38.1%	43.8%	34.3%	40.7%	33.7%	34.5%
純利益率	26.8%	31.0%	25.1%	32.5%	23.5%	24.5%
出荷額	717	725	792	709	678	717

※億円未満 四捨五入

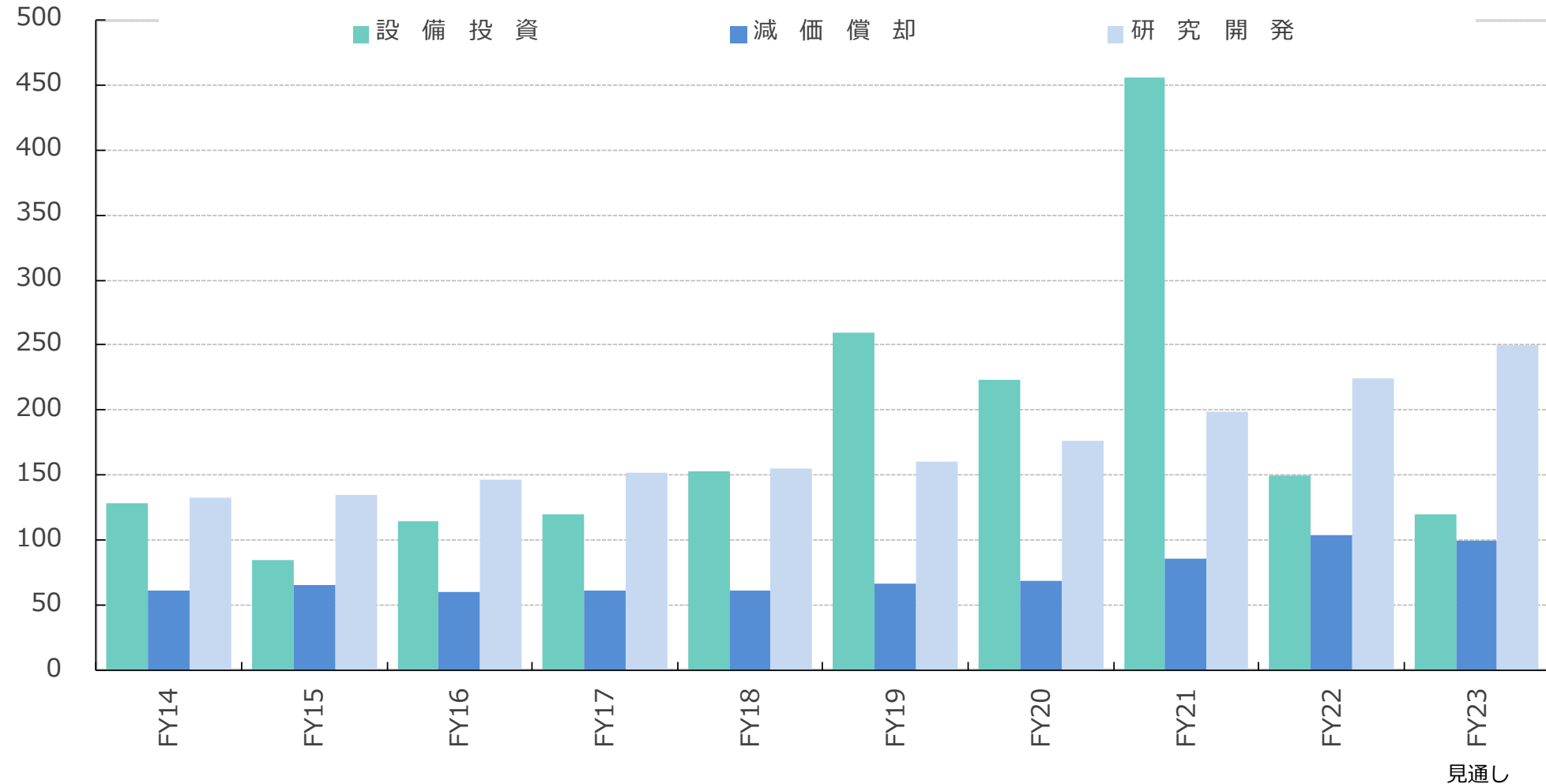
想定為替レート 2Q (7-9月期)
為替感応度 (年換算)

US\$: 130円 Euro : 145円
US\$: 約12億円 Euro : 約3千万円

出荷額ベース

製品群		見通し FY23_2Q 増減率 (QoQ)
	ブレードダイサ	0%
	レーザソー	30%
	ダイサ	15%
	薄化DGP	40%
	薄化以外	0%
	グライнда	15%
	周辺装置	30%
	精密加工装置	15%
精密加工ツール		0%
その他		-20%

単位：億円

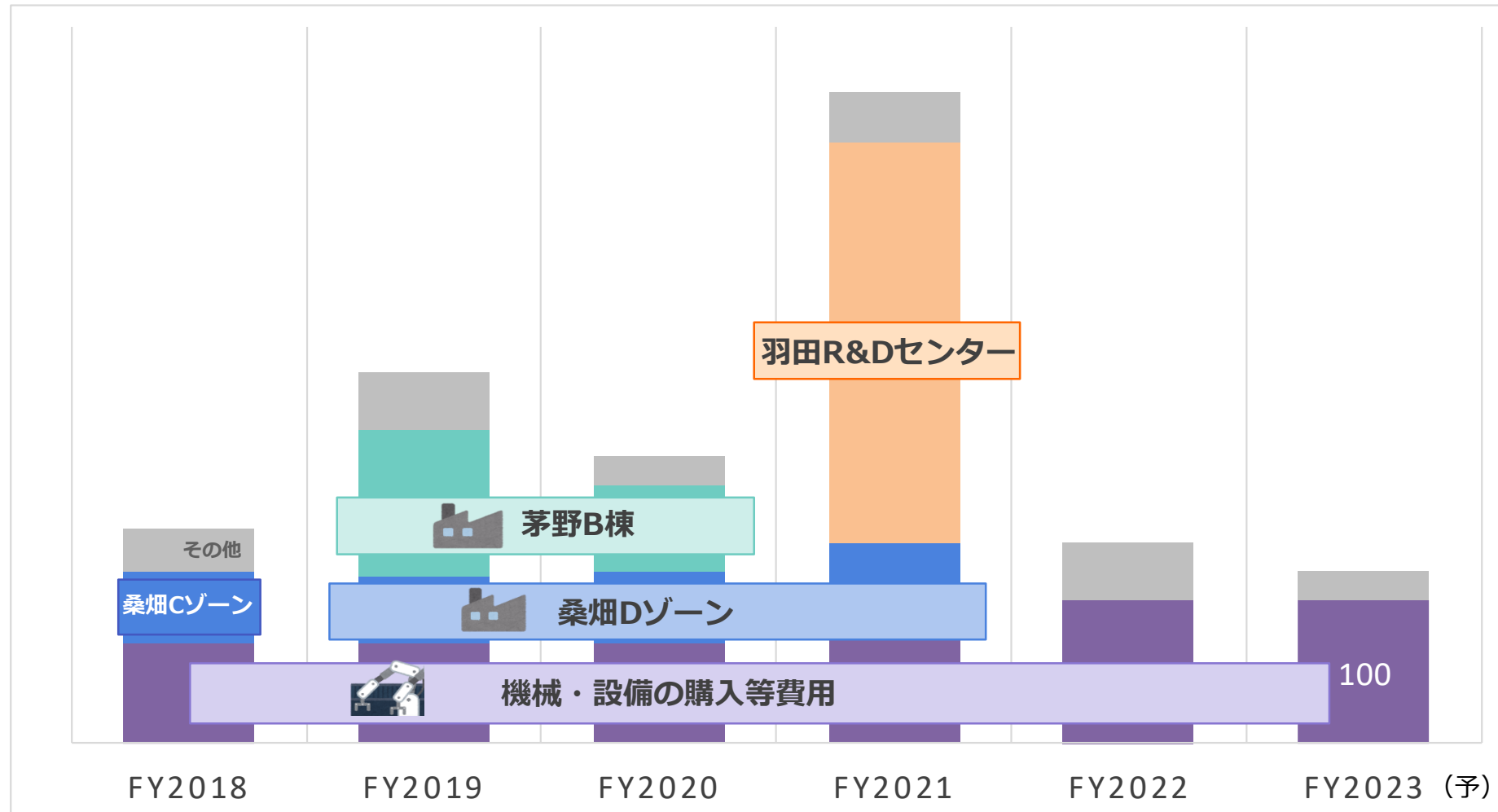


FY23見通し

設備投資：合理化投資を中心に実施
 減価償却：前年度と同等を見込む
 研究開発：積極的な研究開発を予定

120億円程度
 100億円程度
 250億円前後

単位：億円



FY23見通し

機械・設備の購入等費用
他 オフィス拡張など

約100億円
約20億円

- 製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY
	1Q	1Q	1Q
精密加工装置合計	63%	-10%	-6%
内、ダイサ	31%	-13%	-25%
ブレードダイサ	18%	-7%	-26%
レーザソー	12%	-21%	-24%
内、グラインダ	28%	-9%	24%
薄化DGP	11%	-22%	-18%
薄化以外	17%	2%	92%
内、周辺装置	4%	12%	29%
精密加工ツール	21%	10%	-13%
その他	16%	4%	10%
出荷額合計	100%	-4%	-5%

出荷額ベース

		FY22				FY23
製品	用途	22-1Q	22-2Q	22-3Q	22-4Q	23-1Q
ダイサ	1_IC	53%	51%	48%	44%	38%
	2_パッケージ・シグネーチャ	14%	10%	8%	8%	6%
	3_光半導体	6%	6%	8%	9%	12%
	4_その他_半導体	22%	24%	29%	32%	34%
	5_非半導体	5%	8%	7%	8%	10%
ダイサ		100%	100%	100%	100%	100%
グラインダ	1_IC	51%	47%	55%	39%	32%
	2_光半導体	2%	3%	3%	8%	5%
	3_その他_半導体	32%	35%	29%	33%	45%
	4_素材ウエーハ	14%	13%	11%	15%	14%
	5_非半導体	2%	2%	2%	5%	5%
グラインダ		100%	100%	100%	100%	100%

出荷額ベース

		FY22				FY23
製品	用途	22-1Q	22-2Q	22-3Q	22-4Q	23-1Q
ダイサ	1_IC	16%	16%	2%	-27%	-46%
	2_パッケージ・シグネーチャ	11%	-23%	-47%	-53%	-71%
	3_光半導体	-25%	-38%	-20%	8%	55%
	4_その他_半導体	161%	152%	79%	36%	18%
	5_非半導体	-50%	-9%	87%	-36%	40%
ダイサ		18%	16%	10%	-17%	-25%
グラインダ	1_IC	4%	44%	136%	28%	-23%
	2_光半導体	-71%	-63%	-51%	227%	253%
	3_その他_半導体	92%	360%	82%	117%	74%
	4_素材ウエーハ	41%	24%	40%	77%	24%
	5_非半導体	-62%	-59%	-41%	13%	198%
グラインダ		16%	56%	75%	64%	24%

出荷額ベース

		FY22				FY23
製品	用途	22-1Q	22-2Q	22-3Q	22-4Q	23-1Q
ダイサ	1_IC	1%	-7%	6%	-27%	-25%
	2_パッケージ・シグネーチャ	3%	-31%	-17%	-20%	-37%
	3_光半導体	-15%	4%	36%	-10%	22%
	4_その他_半導体	8%	8%	36%	-14%	-6%
	5_非半導体	-51%	55%	-2%	-15%	7%
ダイサ		-4%	-3%	12%	-21%	-13%
グライнда	1_IC	23%	-6%	61%	-31%	-26%
	2_光半導体	-41%	78%	42%	119%	-36%
	3_その他_半導体	51%	12%	17%	10%	21%
	4_素材ウエーハ	22%	-7%	14%	36%	-15%
	5_非半導体	-71%	-7%	57%	166%	-23%
グライнда		20%	1%	39%	-3%	-9%

検収ベース

■ 構成比	FY2022				FY2023
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
日本	10%	10%	12%	13%	13%
アメリカ	9%	9%	15%	16%	10%
アジア	73%	73%	66%	62%	67%
シンガポール	11%	10%	10%	9%	8%
台湾	17%	18%	13%	14%	15%
韓国	14%	10%	7%	9%	8%
中国 ※	29%	34%	34%	28%	35%
その他	2%	1%	1%	2%	1%
ヨーロッパ	8%	7%	7%	8%	10%
合計	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む